

# SLM756

ソフトバンクネットワーク対応のLTE Cat.4通信モジュール、SLM756のご紹介です。



## SLM756

Meilink製  
LTE Cat.4通信モジュール  
(LGA + LCC Type)

Meilink

## 特長

- ・LTE Cat.4対応
- ・パケット通信対応
- ・SMS対応
- ・FOTA対応

## スペック

製品名	SLM756
サイズ	H44.9 × W39.0 × D3.9mm
重量	約9.0g
通信方式	FDD-LTE
周波数	FDD-LTE:B1/3/8 TDD-LTE:B41 W-CDMA:B1/8
電源電圧	3.4V~4.2V
消費電流	通信時：650mA 待受時：7.0mA
外部インターフェース	USB/UART/I2C/SPI/GPIO
制御コマンド	AT Command
動作環境	動作温度：-25~75°C
取得済み認証	JATE/TELEC

本製品はMeilink株式会社より販売します

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.meigsmart.com/productdetail/slm756mz98.html>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。  
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。